

SEMICON[®]
JAPAN

半導体は、電子機器・自動車・生成 AI などの先端技術に欠かせないものであり、高い信頼性と高機能が求められています。さらに、次世代半導体の高集積化により温度・電気的特性評価が重要となります。エスペックでは、次世代半導体の実用化に向けた試験課題に最適な試験装置をご提案いたします。

会期 2024年12月11日(水)～13日(金)
10:00～17:00

会場 東京ビッグサイト(東1ホール)

ブースNo. 1211

出展予定製品

パワー半導体・電子部品の高周波/高耐熱評価

SiC/IGBT対応

パワーサイクル通電試験装置

[Click](#)

半導体デバイスを搭載した電力変換システムの小型化にとって、熱設計が重要な要素となってきています。従来の試験規格に沿った、ショートパワーサイクルからロングパワーサイクル試験と次世代パワー半導体をセラミックス基板へ実装したパワーモジュールの信頼性を評価する技術として、過渡熱抵抗測定を機能追加しました。



半導体特性評価システム

AMMシリーズ

[Click](#)

トランジスタの微細化と集積度向上によりSiO₂よりも低リーク絶縁膜としてハフニウムやジルコニウムの採用が開発が進んでいます。これらの評価に最適なホットキャリア評価(HCI)やTDDB試験に対応可能な評価装置です。

高精度エレクトロマイグレーション評価システム

AEMシリーズ

[Click](#)

AI対応デバイスの微細配線化が進む中で、電気抵抗やエレクトロマイグレーションに対する耐性の向上としてタングステンやコバルトが注目され、400℃下における低電流印加精度(0.1nA～50mA)の評価が可能です。

エレクトロケミカルマイグレーション
評価システム

[Click](#)

高温高湿環境と通電により絶縁不良を加速させ、抵抗値変化を測定することで絶縁劣化を評価します。パソコンによる自動計測、データ収録およびデータ処理のシステム化によって、より正確な接続信頼性評価が可能です。

恒温恒湿器 プラチナスJシリーズ

[Click](#)

省エネ機能と豊富なオプションによりお客様のご要望に合わせた装置のカスタマイズを実現した優れた恒温恒湿器。さらに、低温度域での長期運転で消費電力が抑えられるECOタイプを新たにラインアップしました。



●エスペック製品や技術に関するお問い合わせは

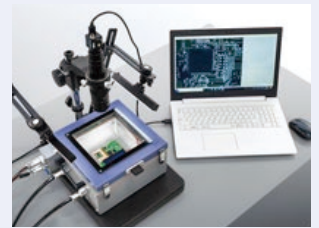
カスタマーサポートデスク  0120-701-678

半導体・実装基板の温度特性評価

卓上型無風恒温槽

[Click](#)

AC100Vで使用可能、屈折率の低い観測窓を採用した無風恒温槽。半導体や実装基板の温度特性評価・熱解析の検証に最適です。



熱変形計測システム

[Click](#)

3次元デジタル画像相関法(3D DIC)を組み合わせ、温度環境下における実装基板の反り変形量の可視化が可能。受託解析も承っております。

スポット冷却加熱装置

[Click](#)

試料を直接冷却・加熱し、チャンパーレスで温度特性評価が可能。先端のアタッチメントを交換することで温度環境下での半導体・電子部品の各種評価試験や材料試験の効率化に優れた試験装置です。



パワー半導体・電子部品の耐湿性評価

高度加速寿命試験装置

[Click](#)

高温・高湿・圧力を同時に試料へ与えることで耐湿性評価が可能。小型化・高性能化する半導体の加速寿命試験に最適です。



来場登録のご案内

[Click](#)

エスペック株式会社 <https://www.espec.co.jp/>

本社 530-8550 大阪市北区天神橋 3-5-6